

## 上海新阳半导体材料股份有限公司

### 关于参股子公司获得政府投资补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）近日接到参股子公司上海新昇半导体科技有限公司（以下简称“上海新昇”）通知，上海新昇于2016年12月27日取得上海市临港地区开发建设管理委员会“关于临港地区2016年度战略性新兴产业项目资金申请报告的批复”（沪临地管委计【2016】57号），上海市临港地区开发建设管理委员会同意将“新昇半导体集成电路制造用300毫米硅片技术研发与产业化项目”列入临港地区2016年度战略性新兴产业项目，并安排

专项资金人民币21244万元以投资补助方式予以支持。具体情况如下：

#### 一、项目简介

专项名称：集成电路制造用300毫米硅片技术研发与产业化项目

项目单位：上海新昇半导体材料科技有限公司

建设周期：2015年5月——2018年12月

#### 二、关于投资补助金额及补助款项拨款进度

根据《临港地区战略性新兴产业发展专项资金管理办法》等相关规定，本项目投资补助款项分三年拨付，进度计划如下：2016年12月拨付人民币8497.6万元（已于2016年12月28日到账）；2017年12月中期审查通过后拨付人民币8497.6万元；2018年12月项目验收后拨付人民币4248.8万元；三年合计拨付投资补助款人民币21244万元。实际补助金额和进度以到账金额和时间为准。

#### 三、财务核算方式及对上市公司影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，上海新昇于收到上述投资补助款项时计入递延收益项目，后期陆续收到的政府投资补助均按此处理，

待项目完工相关资产可供使用时开始进行摊销，分期计入到经营期的收益中。上述投资补助款项对上市公司财务报表当期净利润不会产生重大影响。具体会计处理仍需以会计师年度审计确认后的结果为准。

#### **四、其他风险提示**

集成电路制造用300毫米硅片技术研发与产业化项目目前进展符合预期，虽然上海新昇针对项目运营过程中的各种风险都有相应的防范机制与措施，但仍需提醒投资者注意：本项目在运营过程中会存在质量管控风险、市场开发风险、环保与安全风险等，上述因素都可能给项目的中期审查和最终的验收带来不利影响。上市公司将根据项目实际进展情况及时履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司

董事会

2016年12月30日